北京市高精尖产业发展资金

集成电路设计产品首轮流片奖励实施细则

第一章 总 则

**第一条** 为贯彻落实《中共北京市委 北京市人民政府关于印发加快科技创新构建高精尖经济结构系列文件的通知》（京发〔2017〕27号）、《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》等有关文件精神，充分发挥财政资金引导作用，加快推动我市集成电路设计业技术研发和产品迭代，鼓励我市集成电路产业链协同创新、融合发展，根据《北京市高精尖产业发展资金管理办法》（以下简称《管理办法》），制定本实施细则。

**第二条** 本细则所提资金（以下简称“专项资金”）来源于纳入北京市经济和信息化局（以下简称“市经济和信息化局”）年度部门预算管理的北京市高精尖产业发展资金（以下简称“高精尖资金”），用于重点支持集成电路设计产品首轮流片，提升集成电路设计产业发展的专项资金。

**第三条** 专项资金的使用和管理遵循依法依规、公开透明、公平普惠、达标即享、注重绩效、加强监管的原则。充分发挥财政资金在集成电路设计产业技术升级、产业链优化完善方面的引导和带动作用。

**第四条** 专项资金支持项目由市经济和信息化局负责组织和实施，由北京市财政局负责预算安排和监督使用。

第二章 支持范围和对象

**第五条** 在京注册的从事集成电路设计业务的企业。

**第六条** 申请专项奖励资金支持的单位应具有独立法人资格且近3年无严重失信记录。

第三章 支持条件和标准

**第七条** 支持条件：

1. 申报期内（2021年1月1日以后）开展多项目晶圆（MPW）或工程产品首轮流片（全掩膜），合同已执行完毕，并承诺在京开展该产品产业化工作。

（二）申报本奖励的项目未获得其他市级财政资金的支持。

**第八条** 支持标准：

对开展多项目晶圆（MPW）流片的企业，按照年度流片费用50%予以奖励，每个企业最高不超过300万元；对开展工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按产品流片费用的30%予以奖励，每个企业最高不超过1000万元；对在京代工的工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，奖励比例50%，每个企业最高不超过2000万元。

第四章 项目管理

第九条 专项资金按以下程序管理：

## 项目征集：采取“敞口征集，批次管理”的方式，市经济和信息化局根据年度预算安排，定期发布征集通知，按批次组织实施，申请单位根据通知要求在规定时间内向市经济和信息化局提出申请。

## 项目审核：市经济和信息化局负责组织对申报项目围绕申报要求、申报材料真实性、产业政策符合性、项目合规性、预期绩效分析情况及申报单位信用情况等进行审核，并提出支持方案。

## （三）资金拨付：项目批复后，专项资金由市经济和信息化局直接拨付至项目承担单位。需签订合同的，应在资金拨付前完成合同签订工作。

## （四）过程管理：项目一经批复，不得随意调整，执行过程中确需调整的，按规定履行调整变更程序。

## （五）竣工验收：市经济和信息化局对企业在京生产经营情况、产品本地产业化情况等全过程进行监督检查，可组织专家或委托专业机构进行跟踪评价或监督检查。

## **第十条** 专项资金管理过程中发生的项目前期费用、资料审核、项目评估、绩效评价以及委托管理等费用，可在高精尖资金中列支。涉及政府采购的，按照政府采购有关法律、法规和制度规定执行。

**第十一条** 监督检查、绩效管理、责任与处罚等相关事项依据《管理办法》执行。

第五章 附 则

**第十二条** 本细则由市经济和信息化局负责解释。

**第十三条** 本细则自公布之日起施行。